

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(记录表编号：2026-002)

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 一对一沟通	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026年4月10日		
地点/方式	上证路演中心视频直播和网络互动		
参与单位或人员 (排名不分 先后)	线上参与公司2025年度业绩说明会的投资者		
上市公司 接待人员	董事长：刘绍柏先生 董事兼总裁：刘羽先生 独立董事：曹春方先生 财务总监：孙君磊先生 董事会秘书：黄恬先生		
投资者关系 活动主要内容	<p>Q1：珠海新建的高阶 HDI 厂房什么时候可以投产？投产到盈利要不要几年时间？请刘总正面回复！</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！新建高阶 HDI 厂房计划于 2026 年中试产，公司正在加快推进投产前的准备工作。基于珠海金湾基地原有工厂的成熟智能制造经验、标准化管理体系、专业人才储备、供应链整合能力，新高阶 HDI 工厂具备全流程复制能力，可实现精准快速产线部署，公司对该工厂的发展充满信心，将集中优势资源与核心团队力量，争取早日投产创效。感谢您的关注！</p> <p>Q2：刘总，2025 年公司加大了在珠海金湾基地的战略投入，主要投向什么地方？什么时候可以产生效益？2026 年的投入力度是加大还是？</p>		

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司在珠海金湾基地的战略投入包括但不限于技术研发投入、市场拓展、人才队伍建设、生产设备采购、补充流动资金等方面。目前, 公司正在加速推进珠海金湾基地的技术能力提升及客户订单导入等工作, 效益会逐步释放。公司的战略投入规划基于市场需求及行业技术趋势研判, 具有一定前瞻性, 2026 年, 公司会合理规划投入力度, 既保障短期产能释放、快速响应客户需求, 也有序布局中长期高端产能的规模化储备。未来如有相关事项达到信息披露标准, 公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

Q3: 此前公司说要在珠海金湾基地再多投资 50 亿元, 目前进度怎么样, 现在看是否还会增加投资? 感谢总裁解答!

A: 尊敬的投资者, 您好! 目前已有部分产线投产见效, 该项目的实施进度相对较快。公司的投资规划均基于市场需求及行业技术趋势开展, 公司将严格把控投资风险及项目推进节奏, 为公司后续业务持续高质量拓展提供坚实产能支撑。未来如有相关事项达到信息披露标准, 公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

Q4: 董事长您好, 公司未来 1-3 年对除了 HDI、高多层之外的其他产品的扩产规划如何?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司近年的投资扩产重点围绕面向 AI 算力数据中心的高阶 HDI、超高多层、SLP 等产品开展, 并保持一定规模的其他品类产品扩产。多元化产品与行业布局使公司能更及时地抓住下游市场需求爆发的机遇, 以强大的技术储备和研发能力紧跟产品应用的迭代更新, 为客户提供一站式的解决方案。公司会实时关注行业发展趋势, 积极跟踪行业政策及市场需求的变动, 合理规划扩产, 未来如有相关事项达到信息披露标准, 公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

Q5: 黄董秘, 公司正在赴港上市, 会不会加大分红力度? 投资人会关注的

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司历来重视与广大股东分享企业的成长与发展成果, 在兼顾可持续发展的前提下, 上市以来每年坚持现金分红, 实现

了利润分配的连续性和稳定性，为投资者带来长期稳定的投资回报。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，以总股本 9.85 亿股为基数，预计派发现金红利约 5.42 亿元。未来，公司将继续用实实在在的业绩和更高质量的发展向市场传递价值，用真金白银回报广大股东。感谢您的关注！

Q6: 刘总，你好。2026Q1 业绩是否已经明显受益于 AI 服务器 PCB 放量？利润弹性体现在哪里？

A: 尊敬的投资者，您好！具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q7: 2025 年公司营收增长很快，但毛利率和净利率都略有下降，请问主要原因是什么？2026 年有没有改善毛利率的计划？

A: 尊敬的投资者，您好！2025 年上游原材料价格高位震荡、战略投入、新厂产能爬坡等因素影响，公司毛利率出现一定压力。盈利能力一直是公司密切关注的财务指标，产品结构升级、深化客户合作、海外市场开拓是公司提升中长期盈利能力的三大抓手。感谢您的关注！

Q8: 孙总，你好。公司 2026 年一季度净利润同比增速预计在什么区间？能否实现 80%以上增长？

A: 尊敬的投资者，您好！具体业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q9: 刘总，你好。相比深南、沪电等同行，公司在 AI PCB 领域的份额和增速是否处于第一梯队？

A: 尊敬的投资者，您好！AI 技术进步催生了全球科技产业的深度革新重构，PCB 也迎来了新一轮产能扩张及技术升级的重要机遇，市场的蛋糕足够大，整个价值链协同进步，公司在技术储备、高端产能、产品稳定性与一致性等方面构建了多维优势，有信心在竞争中占据一席之地。感谢您的关注！

Q10: 刘总，你好。公司目前在手订单同比增长多少？二季度业绩环比能否继续加速？

A: 尊敬的投资者，您好！具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后

续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q11: 刘总，你好。珠海高端产能和泰国工厂目前的投产进度、产能利用率如何？今年新增产能主要投向 AI 服务器还是汽车电子，预计何时对业绩形成明显贡献？

A: 尊敬的投资者，您好！珠海金湾基地部分升级产线在 2025 年已投产见效，新建高阶 HDI 工厂计划于 2026 年中试产，泰国生产基地预计于 2026 年内投产。公司近年的投资扩产重点围绕面向 AI 算力数据中心的高阶 HDI、超高多层、SLP 等产品开展，并保持一定规模的其他品类产品扩产，随着技术能力提升及客户订单导入等重点工作的推进，效益会逐步释放。感谢您的关注！

Q12: 刘总，你好。2026 年全年净利润增速目标是多少？是否有信心实现 50%以上增长？

A: 尊敬的投资者，您好！具体业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q13: 请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资者？公司今年的增长点主要是哪些？

A: 尊敬的投资者，您好！2026 年，全球电子产业在 AI 技术的全面赋能下持续变革，为公司高端化发展打开广阔的市场空间，但全球供应链格局重构、地缘政治波动、原材料价格扰动等因素也会给公司经营发展带来一定的挑战，公司将保持战略定力，专注于自身的发展，致力于通过持续的业务增长为股东创造长期价值。感谢您的关注！

Q14: 刘总，你好。在 AI 高速 PCB 领域，公司相对于同行的核心优势是什么？今年在北美云厂商、头部光模块厂的订单份额是否有进一步提升的可能？

A: 尊敬的投资者，您好！AI 技术进步催生了全球科技产业的深度革新重构，PCB 也迎来了新一轮产能扩张及技术升级的重要机遇，市场的蛋糕足够大，整个价值链协同进步，公司在技术储备、高端产能、产品稳定性与一致性等方面构建了多维优势，有信心在竞争中占据一席之地。具体销售情况

及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q15：公司现在重点布局 AI 和汽车电子两大方向，2026 年这两块业务预计会有怎样的增长，哪个会成为更主要的增长动力？

A：尊敬的投资者，您好！公司将持续强化全球第一大汽车 PCB 供应商的领先优势，加速打造 AI 数据基础设施业务增长新动能，关注 AI 端侧应用落地带来的新兴业务机会。感谢您的关注！

Q16：刘总，麻烦问下目前公司的发展规划和路线是什么样的

A：尊敬的投资者，您好！我们将持续深耕印制电路板主航道，深化“1+1+N”业务布局，把握 AI+产业趋势，坚持“以客户为中心”的核心价值观，坚持产品创新与技术升级，积极拥抱科技产业变革带来的挑战与机遇，与产业链上中下游厂商进行深度、纵向链接，聚焦服务全球领先的客户，开发高附加值产品方案，推动高端产能合理扩张；深化变革，持续提升产品质量和运营能力，围绕“以人为本，制造精品，拓展企业，回报社会”的经营理念，打造绿色低碳的现代化企业，进一步巩固和提升市场地位，实现公司高质量、可持续发展。感谢您的关注！

Q17：刘总，你好。公司为英伟达 Blackwell/GB300 体系供货的 PCB 产品，目前订单、出货量和排产情况如何？Rubin 正交背板何时能实现量产贡献收入？

A：尊敬的投资者，您好！具体客户信息请以公司公开信息为准。感谢您的关注！

Q18：刘总，你好。今年是否存在业绩不及预期的风险点？比如订单、价格、产能方面的压力？

A：尊敬的投资者，您好！2026 年，全球电子产业在 AI 技术的全面赋能下持续变革，为公司高端化发展打开广阔的市场空间，但全球供应链格局重构、地缘政治波动、原材料价格扰动等因素也会给公司经营发展带来一定的挑战，公司将保持战略定力，专注于自身的发展，致力于通过持续的业务增长为股东创造长期价值。感谢您的关注！

Q19：刘总，你好。Rubin 正交背板目前处于送样还是量产阶段？何时

能贡献实际收入？

A：尊敬的投资者，您好！具体客户信息请以公司公开信息为准。感谢您的关注！

Q20：刘董，公司是否有计划投资 PCB 产业上下游的标的？

A：尊敬的投资者，您好！公司聚焦 PCB 主航道，围绕公司战略规划，持续关注并系统研判产业链上下游优质投资并购机会，审慎筛选与公司战略方向高度契合的潜在项目。未来如有相关事项达到信息披露标准，公司将按照有关规定履行信息披露义务，请广大投资者以公司披露的相关公告为准。感谢您的关注！

Q21：请独立董事介绍一下如何看待 2026 年下游行业的需求？您认为公司的竞争优势在哪里？

A：尊敬的投资者，您好！在全球数字化进程不断加深的大背景下，AI 技术已成为推动社会经济发展的核心驱动力之一，数据中心、高速网络通信等 AI 基础设施正掀起建设热潮，汽车电子、智能终端、工业控制等下游应用也在加速智能化升级，向 AI 端侧应用深度演进。PCB 是电子设备的基础元件，也是 AI 技术规模化应用的关键硬件基础，PCB 行业正迎来新一轮技术迭代升级的重要机遇。我认为公司的竞争优势主要体现在产品和下游行业布局多元、技术实力雄厚、人才吸引与培养、智能制造、品质管理、绿色生产等多个方面。感谢您的关注！

Q22：刘总，你好。公司为英伟达 GB300、Blackwell 平台供货的 PCB，Q1 营收占比多少？全年收入指引是多少？

A：尊敬的投资者，您好！具体客户信息请以公司公开信息为准。感谢您的关注！

Q23：刘总，你好。公司对 2026 年净利率提升有没有明确目标？能否回升到历史较好水平？

A：尊敬的投资者，您好！产品结构升级、深化客户合作、海外市场开拓是公司提升中长期盈利能力的三大抓手，长期来看，公司有信心通过市场洞察和产品研发的高度匹配、精益生产和数字化管理的可持续发展实现较高

的盈利水平。具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。
感谢您的关注！

Q24：刘总，你好。光模块 PCB 业务今年增速能否达到 200%以上？毛利率是否维持在高位？

A：尊敬的投资者，您好！PCB 是光模块生产制造的基础元件，光模块 PCB 业务是公司持续关注并聚焦能力提升的领域，具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q25：刘总，你好。公司 AI 服务器 PCB 业务 2026 年全年收入指引是多少？预计贡献多少净利润弹性？

A：尊敬的投资者，您好！具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q26：刘总，你好。对比同行高增长，公司 Q1 业绩增速是否弱于行业？主要原因是什么？

A：尊敬的投资者，您好！具体业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q27：孙总，你好。公司 2026 年一季度净利润同比增速能否达到 100%以上？AI 业务是否已成为业绩主要增量？

A：尊敬的投资者，您好！具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q28：刘总，你好。珠海高端产能今年能否满产满销？对全年净利润的具体贡献预期是多少？

A：尊敬的投资者，您好！具体销售情况及业绩情况，请您关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

Q29：1、目前 1.6T 光模块 PCB 市场供需以及公司订单情况如何？2、贵公司称未来大额资本开支聚焦高端产能建设等，请问将重点布局哪些 PCB 品类？为什么？3、如何看待 AI PCB 发展前景，公司针对该板块的具体规划是什么？

A：尊敬的投资者，您好！1、PCB 是光模块生产制造的基础元件，光模

	<p>块 PCB 业务是公司持续关注并聚焦能力提升的领域，具体订单情况请以公司公开信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2、公司近年的投资扩产重点围绕面向 AI 算力数据中心的高阶 HDI、超高多层、SLP 等产品开展，并保持一定规模的其他品类产品扩产。多元化产品与行业布局使公司能更及时地抓住下游市场需求爆发的机遇，以强大的技术储备和研发能力紧跟产品应用的迭代更新，为客户提供一站式的解决方案。3、AI 已成为科技产业发展最重磅的要素之一，PCB 是 AI 技术规模化应用的关键硬件基础，也迎来了新一轮产能扩张及技术升级的重要机遇。公司将加速打造 AI 数据基础设施业务增长新动能，关注 AI 端侧应用落地带来的新兴业务机会；紧扣下游市场需求，科学规划产能建设，稳步推进高端产能释放与全球化产能布局，加速客户导入及高端产能释放，提升高端产品占比。感谢您的关注！</p> <p>Q30：公司是否有融资规划？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！未来如有相关事项达到信息披露标准，公司将按照有关规定履行信息披露义务，请广大投资者以公司披露的相关公告为准。感谢您的关注！</p> <p>Q31：刘总裁，请问公司有没有 SLP 的产能？技术能力如何？下游客户有哪些？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！珠海金湾基地具备 Anylayer 任意阶的量产能力和 mSAP 工艺，可生产 SLP 产品，对该基地的战略投入也会提升包含 SLP 在内的高端产品全流程生产能力。公司关键设备的配置为行业顶尖水平，掌握关键制程的参数及控制方法的成熟度，技术能力储备充足。公司的 SLP 产品可用于高端消费电子、存储芯片/模组及数据中心等领域。感谢您的关注！</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2026 年 4 月 10 日整理